

2024年度 第3四半期 決算説明資料

2025.1.23

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2024 3Q
売上高	93,553
売上総利益	66,622
GP率	71.2%
販売管理費	27,476
営業利益	39,145
経常利益	42,027
経常利益率	44.9%
税前利益	41,866
純利益	31,809

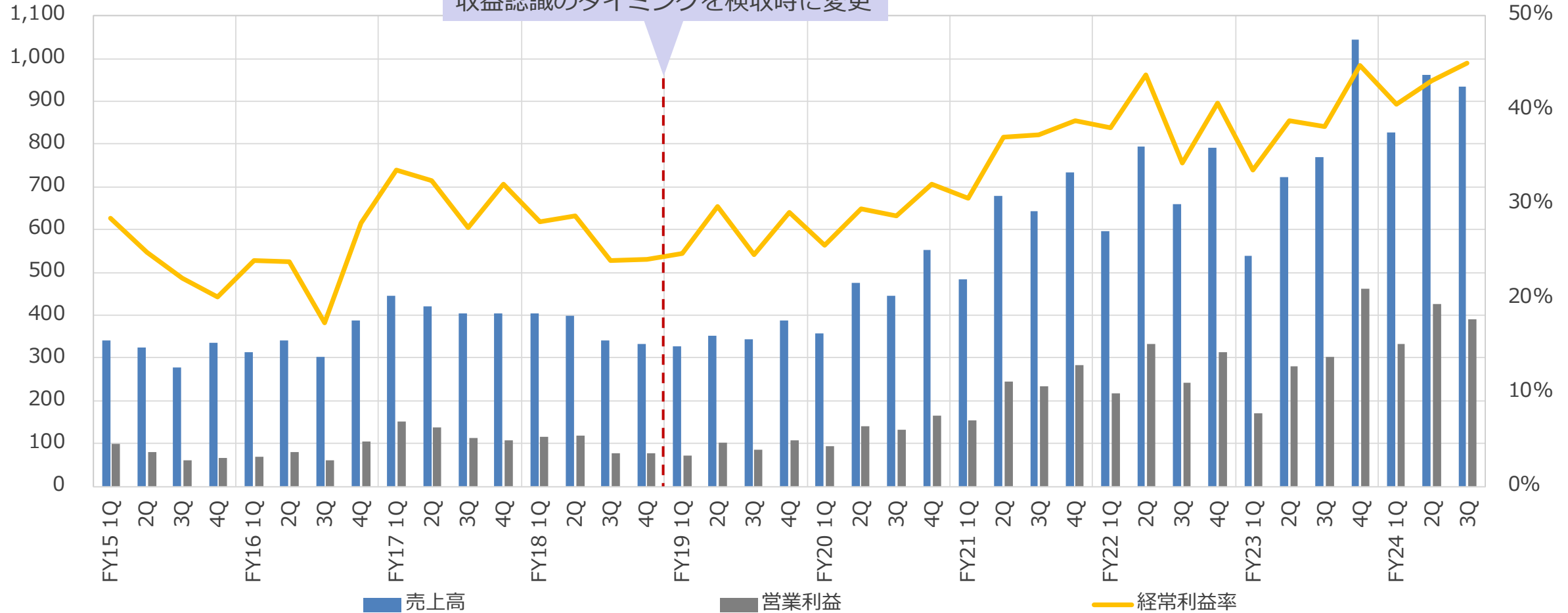
FY2024 2Q	QoQ	
	差額	(%)
96,243	-2,691	-2.8%
69,029	-2,407	-3.5%
71.7%	-0.5p	-
26,454	1,022	3.9%
42,575	-3,430	-8.1%
41,429	598	1.4%
43.0%	1.9p	-
41,317	549	1.3%
29,729	2,080	7.0%

FY2023 3Q	YoY	
	差額	(%)
76,995	16,558	21.5%
52,654	13,968	26.5%
68.4%	2.8p	-
22,300	5,176	23.2%
30,353	8,792	29.0%
29,449	12,578	42.7%
38.2%	6.7p	-
21,876	19,990	91.4%
16,071	15,738	97.9%

売上高： YoY 高水準の出荷と検収の進捗、加えて為替影響により増加
 GP率： YoY 高付加価値製品の寄与および為替影響により上昇
 販売管理費： YoY 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：億円)

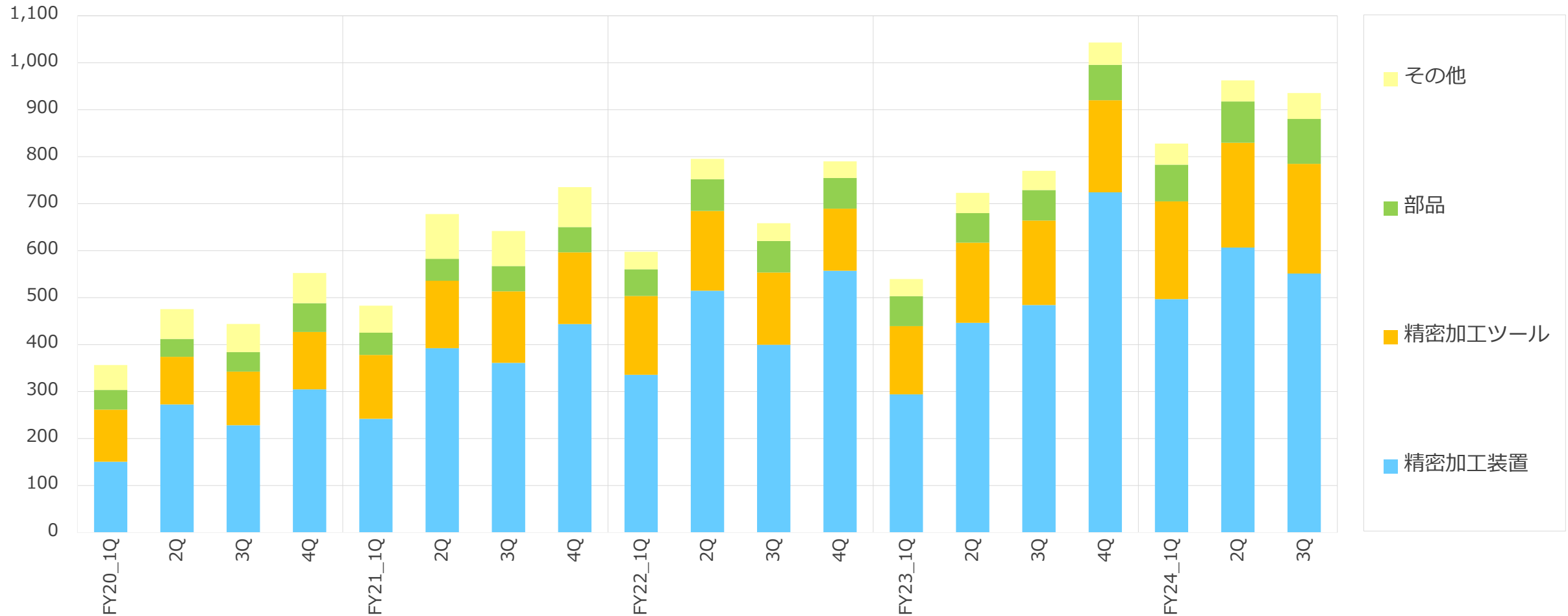
会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更



高いG P率を背景に経常利益率は四半期最高を記録
(FY24_3Q 営業利益率41.8% 経常利益率44.9% 純利益率34.0%)

製品群別売上高 四半期推移

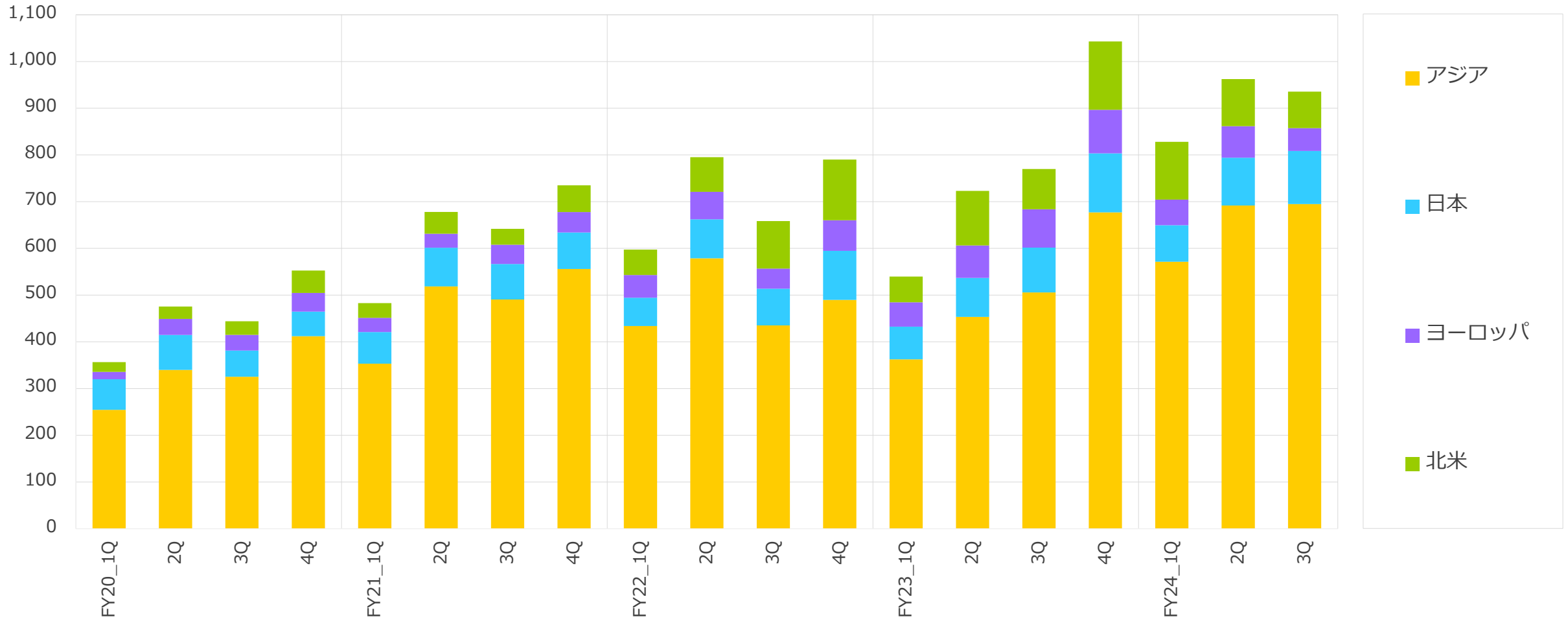
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

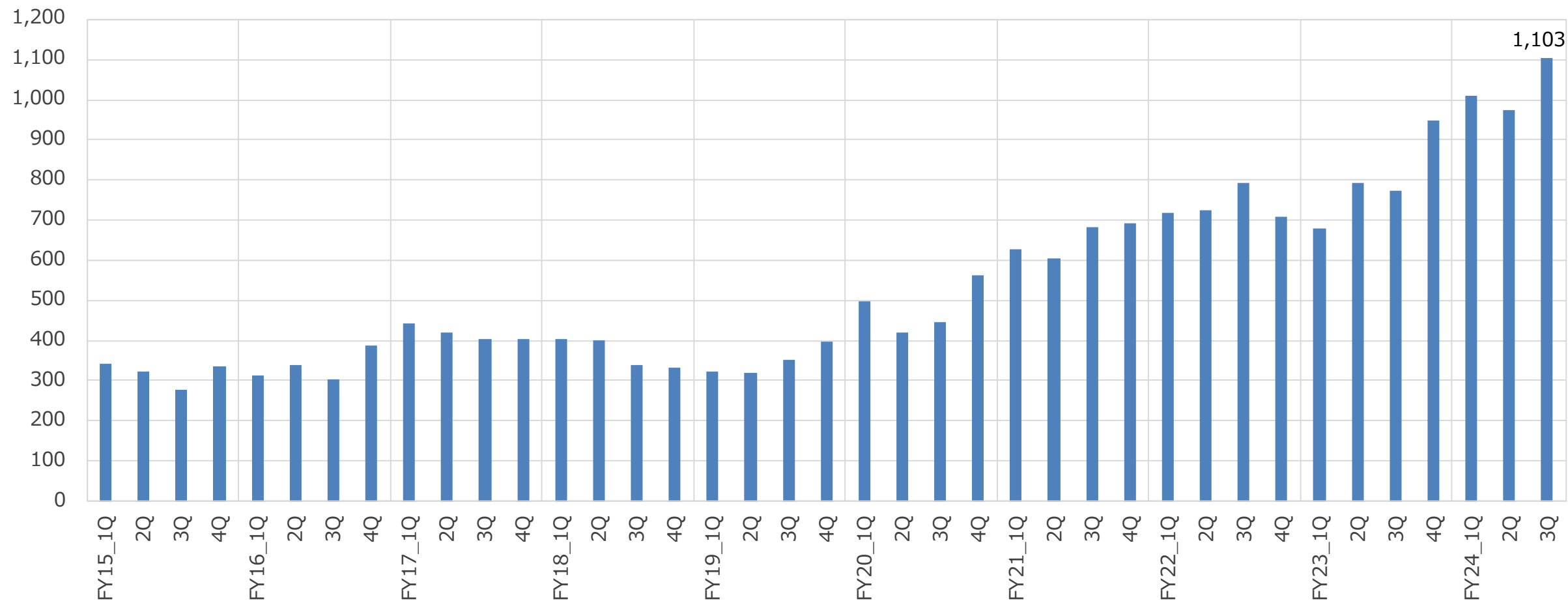
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY24_3Q 海外売上高比率 87.8%

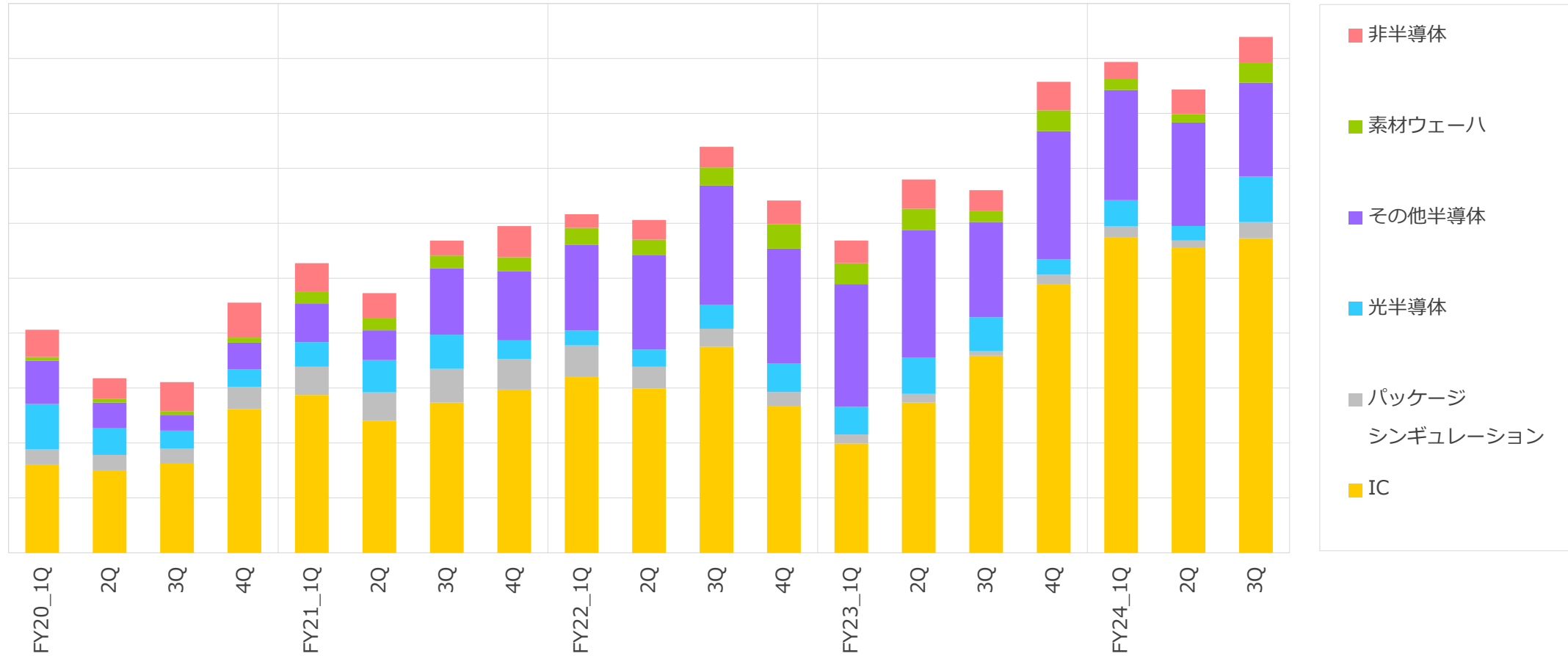
(単位：億円)



FY24_3Q 出荷額 約1,103億円
(四半期最高を記録)

出荷額ベース

精密加工装置

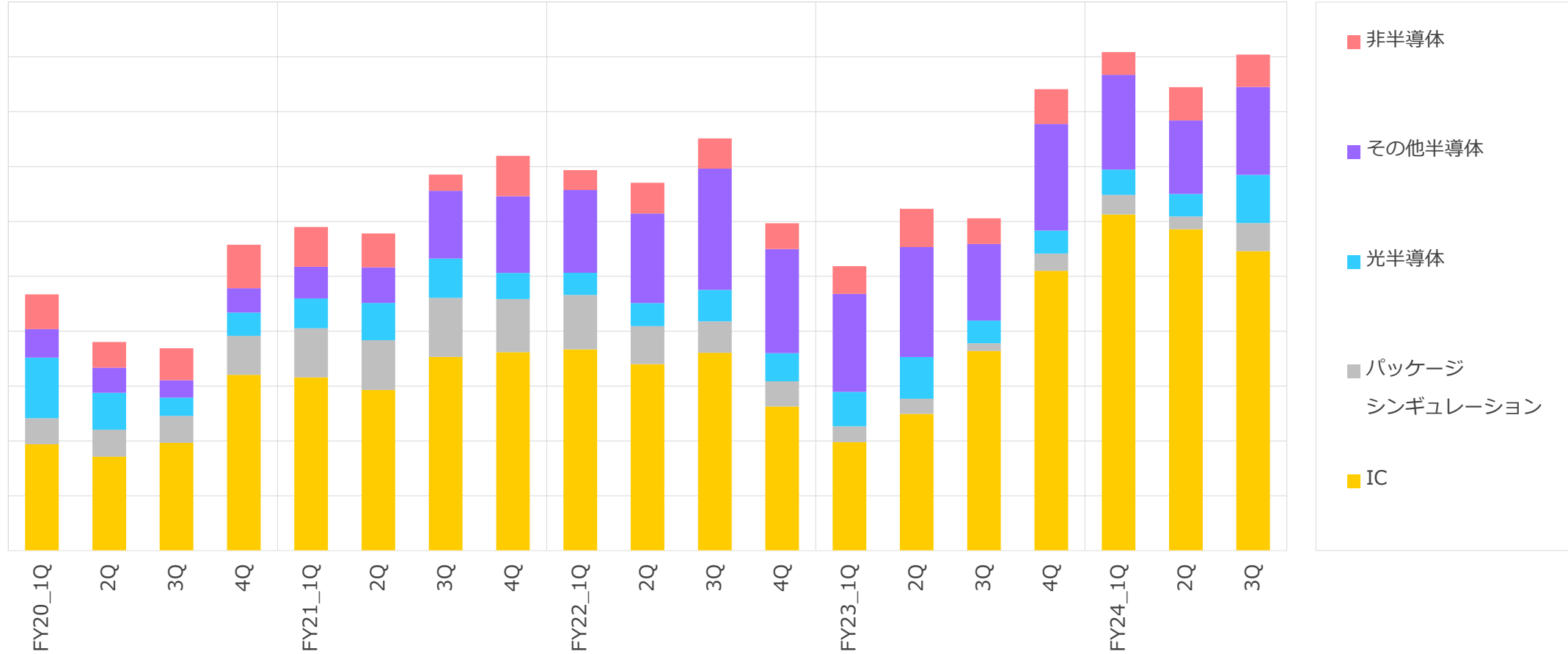


QoQ
YoY

生成AI向けを中心にIC向けが高水準を維持
生成AIの需要拡大を背景にIC向けが増加

出荷額ベース

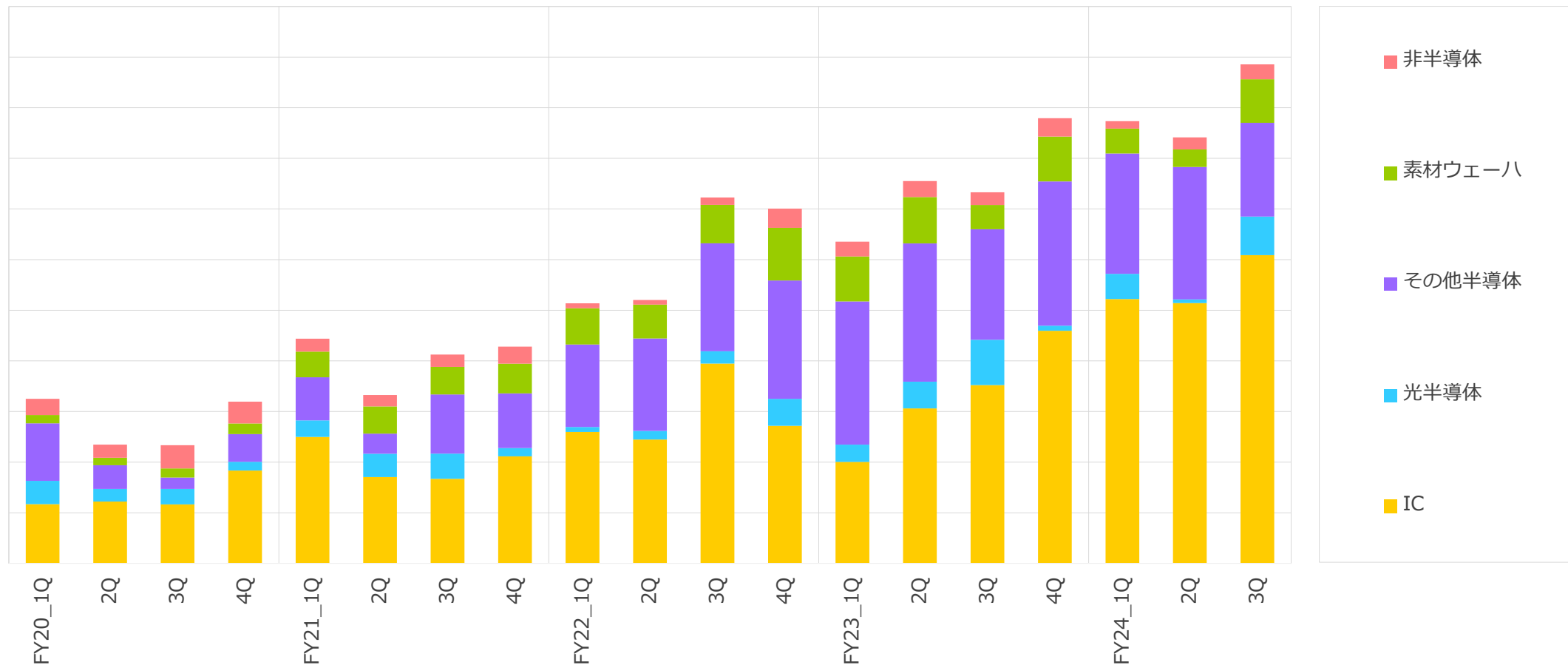
ダイサ



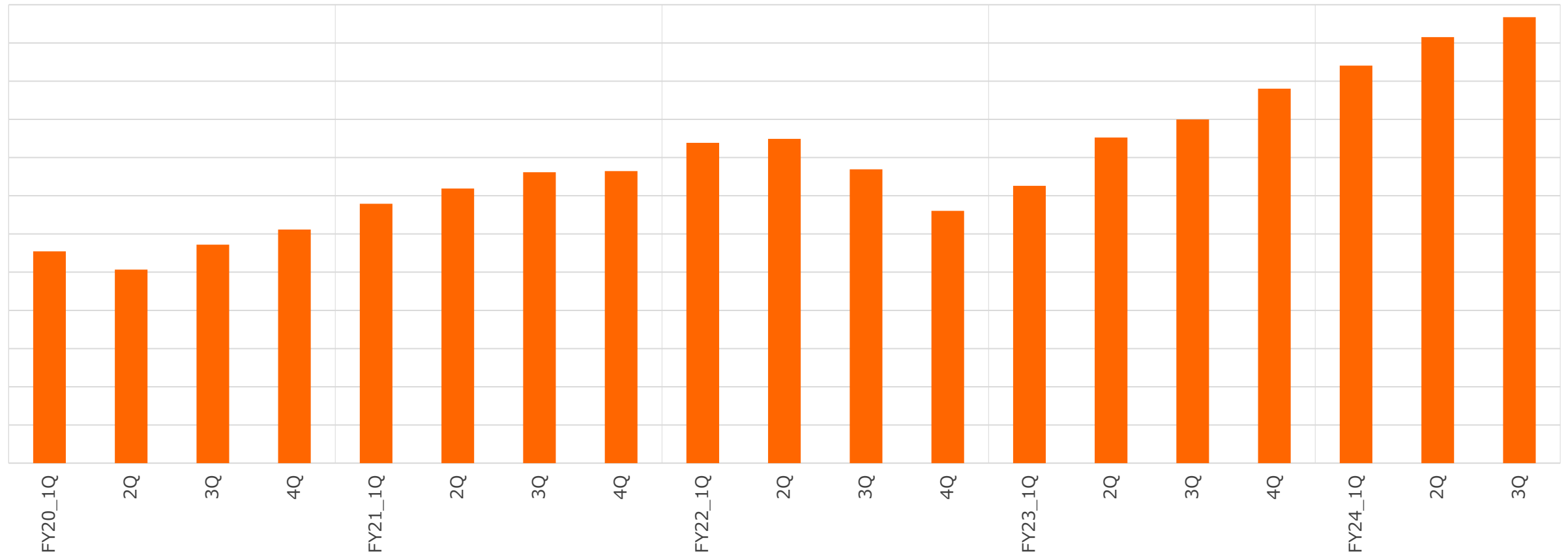
QoQ 堅調なICに加え、光半導体の増加が全体を下支え
 YoY 生成AI向けのIC、およびパワー半導体が増加

出荷額ベース

グラインダ



QoQ 生成AI向けのICに加え、光半導体、素材ウェーハの増加が全体を押し上げた
 YoY 生成AI需要の拡大によりICが増加



精密加工ツール（消耗品）の出荷は季節性による動きや為替影響により高水準で推移

(単位：百万円)	FY2024 3Q	FY2024 2Q	差額
現金及び預金	263,487	243,571	19,916
受取手形・売掛金	42,702	40,586	2,115
棚卸資産	140,858	130,278	10,581
流動資産	456,405	420,812	35,593
有形固定資産	151,687	149,623	2,064
固定資産	172,381	170,185	2,196
総資産	628,786	590,998	37,789
流動負債	173,871	153,706	20,165
固定負債	821	763	58
負債合計	174,692	154,470	20,222
純資産	454,093	436,527	17,566
負債純資産合計	628,786	590,998	37,789
自己資本比率	72.0%	73.6%	-1.6p

総資産：主に現預金や棚卸資産が増加
 負債：主に契約負債や賞与引当金が増加
 純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：億円)

今回予想

	FY23 1Q	2Q	3Q	4Q	FY24 1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	540	723	770	1,043	828	962	936	1,004
営業利益	170	280	304	461	334	426	391	377
経常利益	182	281	294	467	336	414	420	378
純利益	127	200	161	354	237	297	318	276
営業利益率	31.5%	38.8%	39.4%	44.2%	40.3%	44.2%	41.8%	37.6%
経常利益率	33.7%	38.9%	38.2%	44.7%	40.6%	43.0%	44.9%	37.7%
純利益率	23.5%	27.7%	20.9%	34.0%	28.6%	30.9%	34.0%	27.5%
出荷額	678	794	773	950	1,011	976	1,103	961

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 4Q (1-3月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 150円
US\$: 約15億円

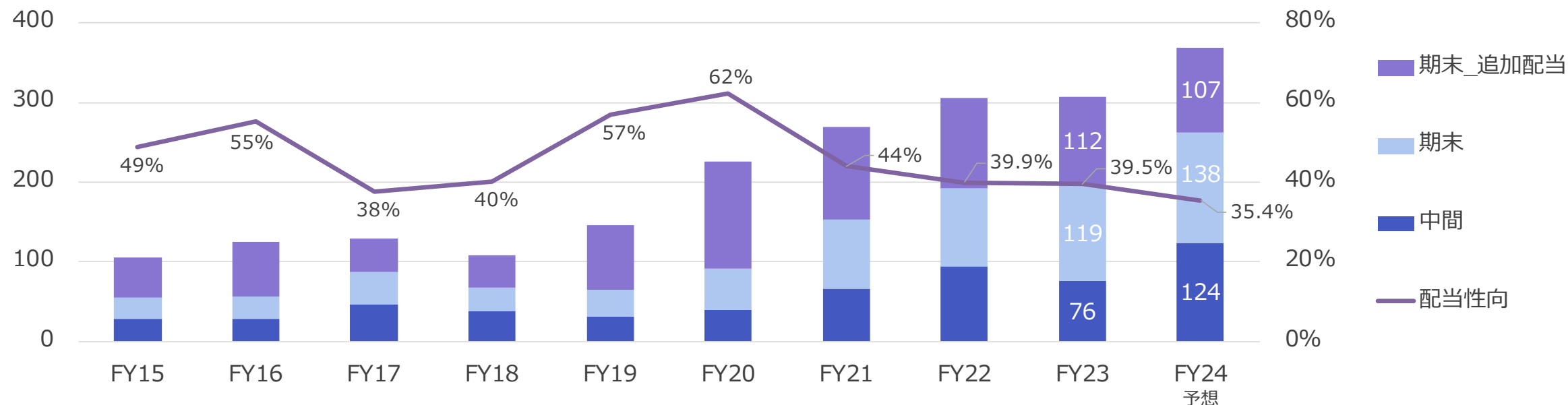
Euro : 155円
Euro : 約1億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など

(単位：円)

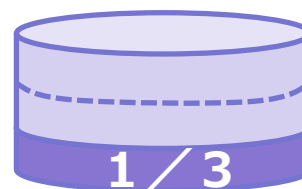
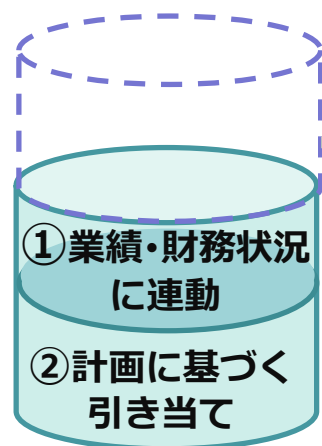
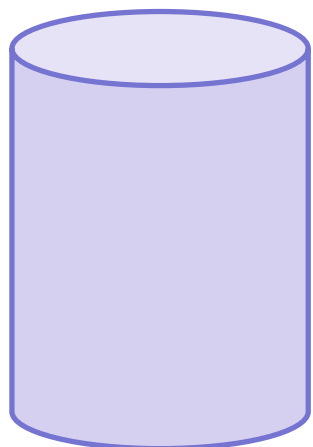


FY24 中間（実績）124円 期末（予想）245円

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
（FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

今回予想

$$\text{年度末現預金 } 1,458 \text{ 億円} \times - \text{必要資金 } 1,113 \text{ 億円} = \text{余剰資金 } 345 \text{ 億円}$$



115億円

追加配当

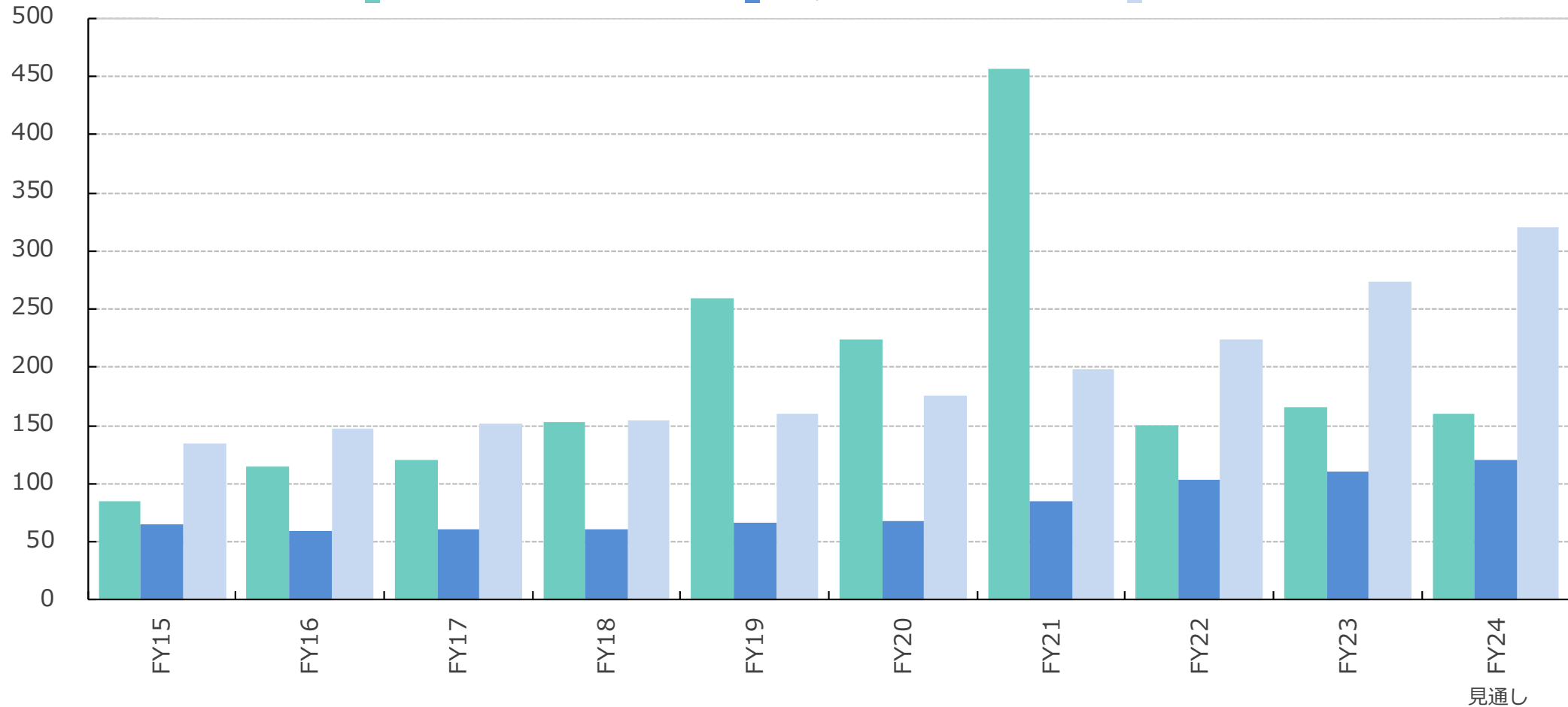
必要資金の内訳

①	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">運転資金</th> </tr> <tr> <td>前期 連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月</td> <td>622 億円</td> </tr> </table>	運転資金		前期 連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月	622 億円
	運転資金				
	前期 連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月	622 億円			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">技術購入予備費(M&A含む)</th> </tr> <tr> <td>連結売上高 過去3年平均 × 10%</td> <td>280 億円</td> </tr> </table>	技術購入予備費(M&A含む)		連結売上高 過去3年平均 × 10%	280 億円	
技術購入予備費(M&A含む)					
連結売上高 過去3年平均 × 10%	280 億円				
<table border="1"> <tr> <td>長期有利子負債 返済資金</td> <td>-</td> </tr> </table>	長期有利子負債 返済資金	-			
長期有利子負債 返済資金	-				
	税金・配当等	290 億円			
②	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">設備拡張資金</th> </tr> <tr> <td>羽田R&Dセンター建替等</td> <td>181 億円</td> </tr> </table>	設備拡張資金		羽田R&Dセンター建替等	181 億円
設備拡張資金					
羽田R&Dセンター建替等	181 億円				
③	<table border="1"> <tr> <td>技術購入予備費の取り崩し</td> <td>▲260 億円</td> </tr> </table>	技術購入予備費の取り崩し	▲260 億円		
技術購入予備費の取り崩し	▲260 億円				

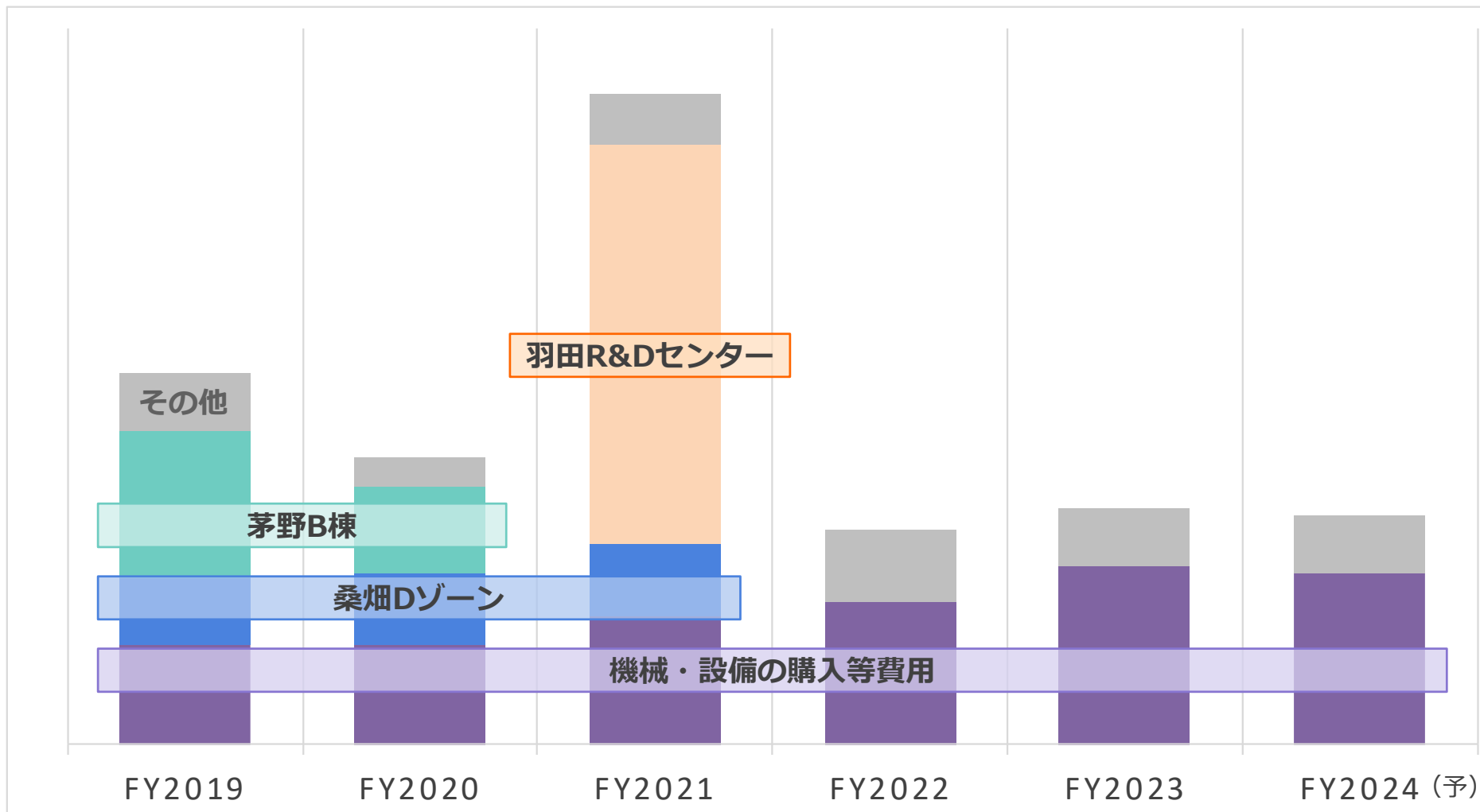
※ 契約負債（前受金）金額などを考慮

(単位：億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却 ■ 研究開発



FY24見通し 設備投資：約160億円 主に合理化投資を実施（羽田R&Dセンター新棟はFY25着工予定）
 減価償却：約120億円 前年度と同等か若干増を見込む
 研究開発：約320億円 積極的な研究開発を継続



FY24見通し

機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

約120億円
約40億円

出荷額ベース

製品群		見通し FY24_4Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	-25%
	レーザーソー	15%
	ダイサ	-5%
	グラインダ	-10%
	周辺装置	5%
精密加工装置		-10%
精密加工ツール		-10%
その他		-35%

【ご参考】 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	3Q	3Q	3Q
精密加工装置合計	63%	10%	42%
内、ダイサ	33%	7%	49%
ブレードダイサ	18%	33%	50%
レーザソー	15%	-14%	49%
内、グラインダ	27%	17%	34%
薄化DGP	19%	29%	62%
薄化以外	8%	-4%	-6%
内、周辺装置	3%	-10%	42%
精密加工ツール	21%	1%	26%
その他	16%	53%	74%
出荷額合計	100%	13%	43%

出荷額ベース

製品	用途	FY23				FY24		
		23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q
ダイサ	1_IC	38%	40%	60%	61%	67%	69%	60%
	2_パッケージ・シンギュレーション	6%	4%	2%	4%	4%	3%	6%
	3_光半導体	12%	12%	7%	5%	5%	5%	10%
	4_その他_半導体	34%	32%	23%	23%	19%	16%	18%
	5_非半導体	10%	11%	8%	8%	5%	7%	7%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	32%	41%	48%	52%	60%	61%	62%
	2_光半導体	5%	7%	12%	1%	6%	1%	8%
	3_その他_半導体	45%	36%	30%	32%	27%	31%	19%
	4_素材ウエーハ	14%	12%	7%	10%	6%	4%	9%
	5_非半導体	5%	4%	3%	4%	2%	3%	3%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY23				FY24		
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q
ダイサ	1_IC	-46%	-27%	1%	94%	210%	135%	50%
	2_パッケージ・シグナレーション	-71%	-60%	-76%	-32%	23%	-15%	270%
	3_光半導体	55%	81%	-28%	-18%	-26%	-46%	112%
	4_その他_半導体	18%	23%	-37%	2%	-3%	-33%	15%
	5_非半導体	40%	24%	-15%	35%	-17%	-13%	26%
ダイサ		-25%	-7%	-19%	41%	75%	36%	49%
グラインダ	1_IC	-23%	25%	-11%	69%	160%	68%	73%
	2_光半導体	253%	207%	267%	-81%	46%	-86%	-15%
	3_その他_半導体	74%	50%	3%	22%	-16%	-4%	-15%
	4_素材ウエーハ	24%	37%	-37%	-15%	-45%	-62%	79%
	5_非半導体	198%	244%	74%	-4%	-50%	-24%	19%
グラインダ		24%	45%	1%	25%	37%	11%	34%

出荷額ベース

		FY23				FY24		
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q
ダイサ	1_IC	-25%	26%	46%	40%	20%	-4%	-7%
	2_パッケージ・シンギュレーション	-37%	-5%	-50%	126%	14%	-34%	119%
	3_光半導体	22%	22%	-46%	1%	10%	-12%	115%
	4_その他_半導体	-6%	12%	-30%	39%	-11%	-22%	19%
	5_非半導体	7%	38%	-33%	36%	-34%	46%	-3%
ダイサ		-13%	20%	-3%	39%	8%	-7%	7%
グラインダ	1_IC	-26%	53%	15%	31%	14%	-2%	18%
	2_光半導体	-36%	55%	70%	-89%	402%	-85%	952%
	3_その他_半導体	21%	-3%	-20%	30%	-17%	10%	-29%
	4_素材ウエーハ	-15%	3%	-48%	85%	-45%	-29%	148%
	5_非半導体	-23%	8%	-21%	46%	-59%	62%	24%
グラインダ		-9%	19%	-3%	20%	-1%	-4%	17%

検収ベース

■ 構成比

	FY2023				FY2024		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
日本	13%	12%	12%	12%	9%	11%	12%
アメリカ	10%	16%	11%	14%	15%	10%	8%
アジア	67%	63%	66%	65%	69%	72%	74%
シンガポール	8%	9%	7%	6%	6%	8%	8%
台湾	15%	11%	10%	12%	16%	17%	19%
韓国	8%	5%	9%	12%	14%	12%	9%
中国 ※	35%	36%	38%	34%	32%	33%	37%
その他	1%	2%	1%	0%	1%	1%	1%
ヨーロッパ	10%	10%	11%	9%	7%	7%	5%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY (Fiscal Year) と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。％は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>